

# はんだ・微細接合部会 シンポジウム

～多様化する実装技術とその高信頼性化～

開催期日：平成30年11月14日（水）

開催場所：溶接会館ホール(2階)（秋葉原）

## 開催趣旨

低炭素社会の実現に向け温室効果ガス削減のシナリオが議論される中、パワーモジュールやエネルギーモジュールの性能向上に向け、半導体素子自身の進歩は目覚ましく、世界中でSiCやGaNなどの半導体材料の研究も進められています。さらに接合などの各要素技術がモジュールの最終的な機能や性能に影響を及ぼし始めていると言われてしています。

今回のシンポジウムでは、高温動作や低消費電力が期待される次世代パワーデバイスに応用が期待される微細接合技術や車載向けなどに応用が期待される新たな実装技術、更にはそれらの高信頼性化技術にフォーカスをあて、最新の技術動向や研究事例を講演頂きます。

皆様のご参加を心からお待ち申し上げます。

主催：一般社団法人 日本溶接協会 はんだ・微細接合部会  
協賛：一般社団法人 エレクトロニクス実装学会 電子部品・実装技術委員会  
一般社団法人 スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会  
一般社団法人 日本溶接協会 マイクロソルダリング要員認証委員会  
後援：一般社団法人 電子情報技術産業協会

(依頼中含む)

## 【開催要領】

1. 日時：平成30年11月14日（水）9：55～16：40
2. 場所：（一社）日本溶接協会（溶接会館）2階ホール
3. 定員：80名（定員になり次第、締め切りとなります。）
4. 参加費：会員 12,000円  
中立機関 10,000円  
学生 5,000円  
非会員 18,000円

（資料代および消費税を含みます。）

※会員とは、日本溶接協会 本部団体会員(<http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp>)

およびマイクロソルダリング資格保持者です。

※協賛団体会員は、日本溶接協会会員に準拠します。

## 【プログラム】

午前の部：

座長：(株)村田製作所 高岡 英清 氏

9:55-10:00 開会挨拶 はんだ・微細接合部会 部会長 島村 将人 氏 千住金属工業(株)

10:00-10:40 「パワーデバイスと実装」

三菱電機 (株) 藤田 淳 氏

10:40-11:20 「次世代パワー半導体の焼結ダイアタッチの高温信頼性」

大阪大学 長尾 至成 氏

11:20-12:00 「Sn-Sb はんだを用いた車載用直接水冷モジュールの高信頼性化」

富士電機 (株) 両角 朗 氏

12:00-13:00

昼食・休憩

午後の部 (Part1)：

座長：長野沖電気(株) 尾形 繁行 氏

13:00-13:40 「低線膨張銅めっきが解消する熱応力」

(株)微小めっき研究所 近藤 和夫 氏

13:40-14:20 「めっき反応およびめっき膜における添加剤の影響」

早稲田大学 齊藤 美紀子 氏

14:20-14:35

休憩

午後の部 (Part2)：

座長：富士通(株) 阿部 知行 氏

14:35-15:15 「ギ酸による銅酸化膜還元過程のリアルタイム測定と考察」

オリジン電気 (株) 小澤 直人 氏

15:15-15:55 「Sn-X 系薄膜インサートを用いた Cu の固液反応拡散接合」

大阪大学 福本 信次 氏

15:55-16:35 「レーザはんだ付におけるはんだ/Cu 界面反応と高信頼性化」

大阪大学 西川 宏 氏

16:35-16:40 閉会挨拶

富士通(株) 阿部 知行 氏  
エレクトロニクス実装学会 電子部品・実装技術委員会 委員長

シンポジウム企画：

(一社) 日本溶接協会 はんだ・微細接合部会微細接合技術分科会

## 【申込要領】

- ・お申込は下記URLからお願いいたします。(オンライン受付)

<https://www-it.jwes.or.jp/seminar/>

- ・参加費は下記の方法でご送金下さい。(銀行振込手数料は各自ご負担下さい。)

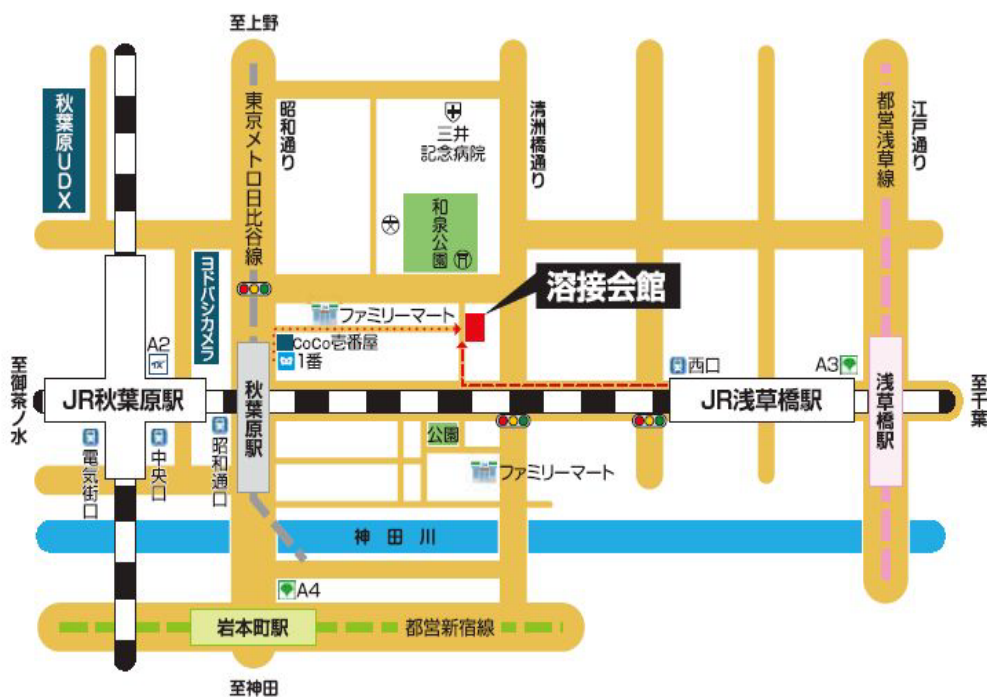
### 銀行振込

三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No.146921 (一社)日本溶接協会  
(原則として銀行口座への振込をもって領収に代えさせていただきます。)

請求書ご希望の場合は、申込時に摘要欄にご記載下さい。

- ・振込後の参加費は返却いたしません。欠席の場合は、代理出席をお願いいたします。
- ・受講確定メールに受講番号が明記されております。当日印刷の上ご持参下さい。
- ・資料は、当日会場受付でお渡しいたします。
- ・申込締切日 平成30年11月5日(月)(定員になり次第、締切となります)
- ・事務局 (一社)日本溶接協会 業務部 金子

TEL : 03-5823-6324 FAX : 03-5823-5244



【所在地】 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町4丁目20番地 溶接会館

### 【交通案内】

- ・ JR秋葉原駅 昭和通口から徒歩8分
- ・ JR浅草橋駅 西口から徒歩8分
- ・ 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 1番出口より徒歩7分
- ・ 都営新宿線 岩本町駅 A4出口より徒歩12分
- ・ 都営浅草線 浅草橋駅 A3出口より徒歩11分
- ・ つくばエクスプレス 秋葉原駅 A2出口より徒歩12分